

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-07

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	海通证券策略会
时间	2023年3月30日
地点	策略会举办地（杭州）
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：张丽君
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司主营业务整体规划布局情况。</p> <p>公司专注于电子互联领域，在不断强化 PCB 业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务，形成业界独特的“3-In-One”业务布局。公司业务覆盖 1 级到 3 级封装产业链环节，具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，为客户提供一站式综合解决方案。</p> <p>分业务下游领域看，公司 PCB 业务产品下游以通信设备为核心，重点布局数据中心、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域；电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，公司主要聚焦通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域；封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。</p>

Q2、公司 PCB 业务 2022 年营收与毛利率的变动原因。

2022 年，公司 PCB 业务营收同比增长 1.01%，业务毛利率同比提升 2.8 个百分点。从营收层面看，2022 年公司 PCB 业务营收增长主要来自海外通信及汽车电子领域，弥补了国内通信领域全年需求放缓、数据中心领域自第三季度以来需求走弱及 EGS 平台服务器芯片发布延期的影响，PCB 业务全年营收规模同比相对保持平稳。从毛利率层面看，公司一方面通过主动优化业务订单结构，提升高盈利产品占比；另一方面通过智能制造、工程设计优化等内部精益改善工作，进一步提高产品质量和工厂运营效率，进而有效促进 PCB 业务毛利率增长。此外，汇率变动、原材料价格回落也对业务毛利率提升有正向作用。

Q3、请介绍公司封装基板业务 2022 年营收与毛利率的变动原因。

2022 年，公司封装基板业务营收同比增长 4.35%，毛利率同比下降 2.1 个百分点。从营收层面看，主要由于 2022 年全球半导体景气逐步走弱，特别自下半年以来全球消费电子市场需求持续回落，对公司部分应用于消费领域的封装基板产品订单需求产生一定影响。同时，公司对存储类产品的客户开发及深耕工作取得显著成效，保障了报告期内封装基板业务稳定的订单来源。封装基板业务全年营收规模微幅增长。从毛利率层面看，受无锡二期基板工厂连线爬坡导致单位固定成本分摊增加，以及下半年以来消费领域需求下行影响，2022 年公司封装基板业务毛利率同比下降。

Q4、请介绍公司电子装联业务 2022 年营收与毛利率的变动原因。

2022 年公司电子装联业务营收同比下降 10.08%，毛利率同比增长 0.6 个百分点，主要由于该业务采用的 Turnkey、Consign 两种销售模式占比变化所影响。此外，公司通过加强精细化管理、升级自动物流与生产自动化等降本增效措施，助益公司电子装联业务毛利率同比增长。

Q5、请介绍无锡、南通子公司 2022 年净利润的变动原因。

2022 年无锡深南实现净利润 3.34 亿元，同比下降 1.56 亿元，主要由于无锡二期基板工厂连线后处于爬坡过程导致固定费用及运营成本的增加。南通深南实现净利润 2.69 亿元，同比增加 1.76 亿元，主要得益于订单结构优化，公司持续开展的智能制造、工程设

计优化等精益改善工作推动产品质量和工厂运营效率进一步提升，南通三期工厂产能爬坡顺利等因素。

Q6、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。在国内通信市场需求放缓、海外通信市场需求持续增长的背景下，公司凭借行业领先的技术实力与高效优质的服务能力，在国内通信市场保持稳定份额，并持续深耕海外通信市场，海外通信业务占比有所提升。从中长期看，国内与海外市场仍存在较大的通信基础设施建设需求，通信市场整体具备发展前景。

Q7、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。2022 年，受益于服务器市场 Whitley 平台切换的推进，公司 Whitley 平台用 PCB 产品占比持续提升。目前，公司已配合客户完成新一代 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。2022 年第三季度以来，受 EGS 平台切换进展延期及下游市场需求下滑影响，公司 PCB 业务数据中心领域短期内承压。

Q8、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。报告期内，伴随公司加大对汽车电子市场开发力度及南通三期工厂连线爬坡，汽车电子订单同比增长超 60%，营收规模同比实现较大增长，但占 PCB 整体营收比重相对较小。目前，汽车电子领域订单保持稳定增长。

Q9、请介绍公司封装基板业务主要客户类型。

公司封装基板业务客户覆盖国内及海外厂商。从客户所处产业链环节看，公司封装基板业务主要面向 IDM 类（半导体垂直整合制造商）、Fabless 类（半导体设计商）以及 OSAT

类（半导体封测商）厂商。

Q10、请介绍公司目前 FC-BGA 封装基板研发进展。

公司现已具备 FC-BGA 封装基板中阶产品样品制造能力，目前已有部分产品向客户进行送样验证。高阶产品技术研发按期顺利推进。

Q11、请介绍公司是否涉及 6G 通信技术。

通信领域是公司长期深耕的重要下游市场之一，目前行业内 6G 技术研发尚处于探索研究阶段。公司对行业前沿技术保持关注和研究，积极探索行业机会并做好相应技术储备。

Q12、请介绍公司目前整体订单情况。

受消费电子领域需求较弱、数据中心下游去库存等因素影响，当前市场整体需求较为平淡。

Q13、请介绍公司南通三期项目连线后产能爬坡进展。

公司南通三期工厂于 2021 年第四季度连线投产，2022 年底已开始盈利，目前产能爬坡进展顺利，产能利用率达到四成以上。

Q14、请介绍公司无锡基板二期工厂连线后产能爬坡进展。

相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡周期较长。无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升。

Q15、请介绍公司广州封装基板项目的建设进展。

公司广州封装基板项目共分两期建设，其中项目一期部分厂房及配套设施主体结构已封顶，尚需完成相关附属配套工程建设。目前项目进展按计划顺利进行，预计将于 2023 年第四季度连线投产。

	注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2023年4月3日